

屹唐半导体

关于北京屹唐半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件
第二轮审核问询函的回复

保荐人（主承销商）



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二一年八月

上海证券交易所：

贵所《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核）（2021）487号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。

根据贵所的要求，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“屹唐股份”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道会计师”或“申报会计师”）对问询意见中所涉及的问题进行了认真核查并发表意见，在此基础上对发行人首次公开发行股票并在科创板上市申请相关文件进行了补充和修订。现将问询意见的落实和修改情况逐条书面回复如下，请予以审核。

如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词释义与《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的相同。

本问询函回复中的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题	黑体
对审核问询函所列问题的回复	宋体
对招股说明书的修改、补充	楷体（加粗）

本问询函回复除特别说明外数值保留2位小数，若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

1.关于招股说明书信息披露	3
2.关于收入	9
3.关于毛利率	13
保荐机构总体意见	15

1. 关于招股说明书信息披露

请发行人：（1）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》（以下简称《准则》）的规定，全面梳理“重大事项提示”“风险因素”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，并在“风险因素”和“重大事项提示”中补充披露以下事项：公司与国际龙头企业存在产品布局上存在较大差距的风险；市场竞争风险，包括快速热处理设备领域市场集中度较高、干法刻蚀设备领域市场份额占比较低等；在“原材料主要采购自境外供应商的风险”中披露境外原材料采购的金额及占比等；（2）按照《准则》的相关规定，以投资者需求为导向，修改招股说明书业务与技术等有关内容，提高信息披露的针对性和有效性。

回复：

一、发行人补充披露情况

发行人已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》规定，结合公司业务与经营具体情况，对“重大事项提示”“风险因素”各项内容予以全面梳理，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，按照重要性进行排序，并就以下楷体加粗部分在招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”中进行补充披露：

“（一）市场竞争风险

伴随集成电路产业的快速发展，良好的发展前景吸引诸多国内企业进入这一领域；同时以应用材料、泛林半导体、东京电子为代表的国际集成电路制造设备巨头较早进入市场，并在巩固自身优势基础上积极进行技术升级，产品具备较强的市场竞争力。

根据 Gartner 统计数据，在快速热处理设备领域，公司 2020 年凭借 11.50% 的市场占有率位居全球第二，而排名第一的应用材料市场占有率高达 69.72%；在干法刻蚀领域，公司 2020 年凭借 0.1% 的市场占有率位居全球第十，而前三大厂商泛林半导体、东京电子及应用材料合计占有全球干法刻蚀设备领域 90.24% 的市场份额。公司在快速热处理及干法刻蚀领域，与国际巨头相比市场占有率

仍有较大差距。

若公司不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则可能对公司的行业地位、市场份额、经营业绩等产生不利影响。

（二）与国际龙头在产品线覆盖广度存在较大差距的风险

在集成电路设备领域，应用材料、泛林半导体、东京电子等国际龙头成立时间长，且北美、欧洲、日韩等地区半导体市场发展程度更高，国际龙头产品线布局相对完善。应用材料产品覆盖领域包括等离子体刻蚀、单晶圆热处理、化学气相薄膜沉积、物理气相薄膜沉积、外延薄膜沉积、离子注入、检测等；泛林半导体、东京电子等在等离子体刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗、显影、检测等领域拥有较为成熟的产品组合。公司主要产品包括干法去胶设备、快速热处理设备及干法刻蚀设备在内的三类集成电路设备。

更广泛的产品线覆盖程度可以使得集成电路设备制造企业为客户提供更为全面、综合的产品及服务。现阶段，公司产品线覆盖广度上与上述国际巨头尚存在一定差距，公司在行业内的综合竞争力与国际龙头企业相比仍存在不足。

（三）贸易摩擦风险

公司在中国、美国、德国、韩国、日本等多个国家或地区开展业务，且主要原材料采购自境外供应商。报告期内，公司来自境外供应商的原材料采购金额分别为 85,927.00 万元、98,656.67 万元和 154,831.08 万元，占当期原材料采购金额比例分别为 99.9975%、99.9932%和 99.2403%。如果未来相关国家及地区出于贸易保护等原因，通过关税和进出口限制等贸易政策，构建贸易壁垒，公司可能面临与上下游合作伙伴继续合作受限、供应链稳定性受到影响、自主研发和产品升级受阻等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

（六）存货跌价的风险

报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 82,100.21 万元、104,784.82 万元和 132,445.70 万元，占流动资产的比例分别为 69.07%、64.95%和 34.18%，占比较高，其中原材料和发出商品为公司存货的主要构成。报告期各期末，公司库龄在一年以上的存货余额分别为 19,569.11 万元、19,324.88 万元和

27,728.76 万元，占各期末存货余额的比例分别为 20.62%、16.18%和 19.02%。报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 12,820.73 万元、14,680.48 万元和 13,347.36 万元。

公司原材料主要包括机械类、电气类、机电一体类、气体输送系统类等生产用部件及备品备件，库龄一年以上的原材料主要包括公司为确保在专用设备销售之后可以持续稳定地向客户供应与原型号设备匹配的零部件而储备的备品备件，以及对采购周期较长的原材料进行一定规模的安全备货。公司发出商品主要为已经发往客户、正在安装调试尚未取得客户最终验收确认的专用设备，因部分客户对特定专用设备验证周期较长导致公司部分发出商品库龄超过一年。如果未来公司产品需求、销售价格发生重大不利变化或发出商品在客户端未能通过验收而被退回，可能导致存货可变现净值低于成本，需要计提存货跌价准备，从而影响公司的盈利水平。”

上述楷体加粗部分内容已同步在招股说明书“第四节 风险因素”中进行了补充披露。

二、发行人对招股说明书业务与技术等有关内容的修订情况

发行人已按照《准则》的相关规定，以投资者需求为导向，修改招股说明书业务与技术等有关内容，提高信息披露的针对性和有效性。主要修订情况如下：

修订位置 (对应首轮问询后招股说明书)	原披露内容	修订后
第六节 业务与技术/ 一、公司主营业务、主要产品或服务情况/ (一) 公司主营业务情况	<p>公司主要设备相关技术达到国际领先水平，产品已应用在多家国际知名集成电路制造商生产线上并实现大规模装机。公司干法去胶设备、快速热处理设备主要可用于90纳米到5纳米逻辑芯片、10纳米系列 DRAM 芯片以及32层到128层3D 闪存芯片制造中若干关键步骤的大规模量产；干法刻蚀设备主要可用于65纳米到5纳米逻辑芯片、10纳米系列 DRAM 芯片以及32层到128层3D 闪存芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。</p>	<p>公司主要设备相关技术达到国际领先水平，报告期内，干法去胶设备、快速热处理设备已应用在多家国际知名集成电路制造商生产线上并实现大规模装机，干法刻蚀设备已应用在三星电子、长江存储等知名集成电路制造商生产线上并正在持续进行市场开拓。具体而言，公司干法去胶设备、快速热处理设备主要可用于90纳米到5纳米逻辑芯片、1y 到2x 纳米系列 DRAM 芯片以及32层到128层3D 闪存芯片制造中若干关键步骤的大规模量产²；干法刻蚀设备主要可用于65纳米到5纳米逻辑芯片、1y 到2x 纳米系列 DRAM 芯片以及32层到128层3D 闪存芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。</p> <p>²“大规模量产”指公司专用设备可用于下游客户大规模生产的量产产线，下同</p>
第六节 业务与技术/ 一、公司主营业务、主要产品或服务情况/ (二) 公司主要产品介绍/1、专用设备	<p>-</p>	<p>从具体制程及技术节点来看，在逻辑芯片领域，28nm 在行业内被视作先进制程和成熟制程的分水岭，28nm 以内的为行业内先进制程。报告期内，公司销售的专用设备中应用于逻辑芯片领域 28nm 以内（含 28nm）制程的设备台数分别为 24 台、60 台、83 台，占逻辑芯片领域销售设备总数的比例分别为 75.00%、98.36%、97.65%，先进制程占比整体呈上升趋势且整体占比超过 90%；公司销售的专用设备中应用于逻辑芯片领域 10nm 以内（含 10nm）的设备销售数量分别为 15 台、40 台、40 台，占逻辑芯片领域销售设备总数整体比例超过 50%。</p> <p>在 DRAM 芯片领域，1y-2x nm 范围制程为行业内成熟及先进技术节点。报告期内，公司销售的专用设备中应用于 DRAM 芯片领域 1y-2x nm 范围制程的设备台数分别为 24 台、19 台、28 台，占 DRAM 芯片领域销售设备总数的比例分别为 96.00%、95.00%、100.00%，成熟及先进技术节点设备占 DRAM 芯片领域销售设备总数整体超过 95%。</p> <p>在闪存芯片领域，64层为行业内成熟技术节点，96层以上（含96层）为行业内先进技术节点。报告期内，公司销售的专用设备中应用于闪存芯片领域64层以上（含64层）</p>

修订位置 (对应首轮问询后招股说明书)	原披露内容	修订后
		的设备台数分别为18台、9台、51台，占闪存芯片领域销售设备总数的比例分别为94.74%、90.00%、100.00%，成熟及先进技术节点设备占比整体超过90%；公司销售的专用设备中应用于闪存芯片领域96层以上（含96层）的设备销售数量分别为8台、3台、25台，先进技术节点设备占闪存芯片领域销售设备总数整体超过40%。
第六节 业务与技术/ 一、公司主营业务、主要产品或服务情况/ (三) 主营业务模式 /5、销售模式	报告期内，公司仅佳能营销公司一家经销商。	报告期内，公司仅佳能营销公司一家经销商， 经销模式为买断式。
第六节 业务与技术/ 二、发行人所在行业的基本情况/(三) 所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况与未来发展趋势	1、半导体概况 ...	予以整体删除
第六节 业务与技术/ 二、发行人所在行业的基本情况/(七) 公司的竞争优势与劣势 /2、主要竞争劣势	(2) 细分领域市场占有率仍有较大提升空间 根据 Gartner 统计数据，在干法去胶设备领域，公司2020年凭借31.29%的市场占有率位居全球第一；在快速热处理设备领域，公司2020年凭借11.50%的市场占有率位居全球第二，而排名第一的应用材料市场占有率高达69.72%；在干法刻蚀领域，公司2020年凭借0.1%的市场占有率位居全球第十，而前三大厂商泛林半导体、东京电子及应用材料合计占有全球干法刻蚀设备领域90.24%的市场份额。 公司在所处细分领域市场占有率仍有较大提升空间；尤其在快速热处理、干法刻蚀领域，与国际巨头相比市场占有率仍有较大差距。	(2) 快速热处理及干法刻蚀 领域市场占有率仍有较大提升空间 根据 Gartner 统计数据，在快速热处理设备领域，公司2020年凭借11.50%的市场占有率位居全球第二，而排名第一的应用材料市场占有率高达69.72%；在干法刻蚀领域，公司2020年凭借0.1%的市场占有率位居全球第十，而前三大厂商泛林半导体、东京电子及应用材料合计占有全球干法刻蚀设备领域90.24%的市场份额。因此，公司在快速热处理及干法刻蚀领域，与国际巨头相比市场占有率仍有较大差距。
第六节 业务与技术/ 二、发行人所在行业的基本情况/(八) 面临的机遇与挑战/1、行业发展态势及面临的	集成电路制造行业巨头如台积电、三星电子、海力士、美光科技等不断扩大资本性支出，半导体领域投资热度提升将对包括集成电路制造设备行业在内的细分行业产生拉动效应。	集成电路制造行业巨头如台积电、三星电子、海力士、美光科技等不断扩大资本性支出， 根据 Gartner 数据，全球集成电路制造厂商资本性支出规模预计将由2020年的1,105.36亿美元增长至2022年的1,456.22亿

修订位置 (对应首轮问询后招股说明书)	原披露内容	修订后
机遇/(1)产品应用场景扩展,推动市场需求持续向上		美元,复合增长率 14.78% 。半导体领域投资热度提升将对包括集成电路制造设备行业在内的细分行业产生拉动效应。
第六节 业务与技术/ 二、发行人所在行业的基本情况/(九)发行人与同行业竞争对手的比较情况/1、经营情况对比	-	公司整体业务规模较应用材料、东京电子、泛林半导体等国际巨头仍有一定差距。公司毛利率水平低于应用材料、东京电子、泛林半导体等国际巨头,主要系国际巨头成立时间较长,产品线覆盖较广,技术、产品线组合等方面较公司有一定优势。
第六节 业务与技术/ 三、发行人销售情况和主要客户/(一)主要产品产销情况/1、主要产品规模	-	报告期内,公司干法去胶设备产量及销量均大幅增长;快速热处理设备产量及销量基本保持稳定;干法刻蚀设备尚处于市场开拓阶段,产量及销量相对较低。
第六节 业务与技术/ 三、发行人销售情况和主要客户/(一)主要产品产销情况	-	<p>4、主要产品应用情况</p> <p>从具体应用领域来看,公司干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备主要应用于逻辑芯片、闪存芯片、DRAM芯片三大主流应用领域。报告期内,公司销售的专用设备中应用于上述三大应用领域的专用设备台数逐年合计分别为76台、91台、164台,占当期全部应用领域专用设备销售数量的比例分别为80.85%、75.21%、85.42%;公司销售的专用设备中应用于逻辑芯片、闪存芯片、DRAM芯片三大应用领域的专用设备销售收入合计分别为79,166.56万元、78,580.54万元、144,059.63万元,占当期全部应用领域专用设备销售收入的比例分别为84.16%、72.87%、85.07%。</p>
第六节 业务与技术/ 四、发行人采购情况和主要供应商/(一)主要原材料及能源采购情况	-	<p>(2) 主要原材料采购来源</p> <p>报告期内,公司的原材料采购以境外供应商为主。</p> <p>为降低采购成本和时间,降低供应链风险,公司积极推进供应链多元化、本土化。目前,公司干法去胶设备供应链本土化已处于试运行阶段。在不改变工艺且完全兼容客户现有生产线的设计前提下,硅片传输系统、硅片传输机械手、气体控制柜等核心原材料已具备本土备选供应商,射频电源等核心原材料已具备日本备选供应商。根据目前进度,公司预计将于2021年下半年完成干法去胶</p>

修订位置 (对应首轮问询后招股说明书)	原披露内容	修订后
		<p>设备主要机型的关键本土备选零部件内部认证,2022年分阶段实现国产零部件量产导入。</p> <p>干法刻蚀设备原材料构成与干法去胶设备接近,因此,按照公司目前的生产物料清单测算,干法刻蚀设备备选供应商原材料覆盖程度预计可达到较高比例。</p> <p>快速热处理设备主要机型的相关原材料供应主要来源于德国,供应链本土化工作于2021年下半年正式启动,预计于2023年之前完成。</p>
第六节 业务与技术/ 五、发行人主要固定资产和无形资产/(一) 主要固定资产	-	<p>发行人机器设备主要为研发及生产过程所需的实验室机台设备、检测设备等。</p>
第六节 业务与技术/ 五、发行人主要固定资产和无形资产/(二) 主要无形资产	-	<p>注:公司专利技术为公司在收购 MTI 过程中所识别并确认的无形资产</p>

关于招股说明书修订的完整情况,发行人及保荐机构已出具《关于招股说明书修订情况的说明》。

2. 关于收入

根据问询回复:(1)干法去胶设备中应用于逻辑芯片 5nm 以内的销售收入、占比分别由 2019 年的 X 万元、X%下降至 2020 年的 X 万元、X%, 18-28nm 的销售收入、占比分别由 2019 年的 X 万元、X%上升至 2020 年的 X 万元、X%;(2)备品备件均为公司交由供应商定制化生产或公司采购的通用型配件;(3)公司在美国专用设备销售客户主要为客户 R 和客户 S,客户 R 因 2019 年行业景气度下行及 2020 年新冠疫情爆发等原因推迟了资本性开支计划,客户 S 在 2019 年及 2020 年未向公司采购快速热处理设备。

请发行人说明:(1)公司应用于 5nm 以内产品收入大幅下降、18-28nm 产品

收入大幅上升的原因，与行业变动趋势是否一致；（2）报告期各期，区分定制化、通用型备品备件的收入占比和毛利率；（3）2019-2020 年客户 S 未向公司采购快速热处理设备的原因，2021 年公司对客户 R、客户 S 的销售及在手订单情况，发行人在美国的新客户拓展情况。

请保荐机构、申报会计师核查上述事项并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）公司应用于 5nm 以内产品收入大幅下降、10-28nm 产品收入大幅上升的原因，与行业变动趋势一致

2019 年、2020 年，公司干法去胶设备中应用于逻辑芯片 5nm 以内、10-28nm 产品的销售情况如下表所示：

单位：台、万元

制程节点	2020 年度		2019 年度	
	销量	销售收入	销量	销售收入
5nm 以内（含 5nm）	X	X	X	X
10-28nm（含 28nm）	X	X	X	X

报告期内，受益于国内半导体行业景气度提升及公司持续开拓国内市场，公司来自于境内客户的收入取得大幅提升，在逻辑芯片领域，国内厂商中目前最先进的量产制程为 14nm，其余国内客户制程需求以 14-28nm（含 28nm）或 28nm 以上设备为主，国内客户需求的提升导致公司成熟制程设备销量大幅提升。2019 年、2020 年，发行人应用于逻辑芯片 10-28nm（含 28nm）的干法去胶设备销售收入由 X 万元增长至 X 万元，增加 X 万元，其中来自于境内客户的收入分别为 X 万元和 X 万元，境内客户收入增加 X 万元。因此，2020 年应用于 10-28nm（含 28nm）收入增长主要来自于境内销售增长。

根据目前全球知名集成电路厂商制程研发进展，5nm 以内制程设备的需求集中于某些主要客户。通常情况下，客户会综合考虑其下游客户预期订单情况、资

本开支规模整体规划等因素确定设备采购计划。公司应用于逻辑芯片 5nm 以内（含 5nm）的干法去胶设备销售收入自 2019 年的 X 万元下降至 X 万元，主要与客户采购计划相关。2021 年以来，随着半导体行业景气度持续提升，多数芯片制造厂商加大先进制程领域的资本开支。2021 年 1-6 月，公司 5nm 以内（含 5nm）的干法去胶设备合计已实现销售收入约 X 亿元（未经审计）。

综上，2019 年-2020 年期间，公司应用于 5nm 以内产品收入下降、10-28nm 产品收入大幅上升具有合理性，与行业变动趋势不存在差异。

（二）报告期各期，定制化、通用型备品备件的收入占比和毛利率

报告期内，公司备品备件销售区分定制化、通用型的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
定制化	收入	45,135.02	81.75%	34,957.76	81.11%	40,036.42	78.75%
	毛利率	56.54%	-	57.27%	-	59.09%	-
通用型	收入	10,077.06	18.25%	8,139.93	18.89%	10,803.71	21.25%
	毛利率	55.61%	-	56.85%	-	57.22%	-
合计	收入	55,212.08	100.00%	43,097.69	100.00%	50,840.12	100.00%
	毛利率	56.37%	-	57.19%	-	58.69%	-

如上表所示，报告期内公司备品备件主要为定制化采购，各年销售收入占比在 80% 左右。报告期内，定制化及通用型产品毛利率水平不存在重大差异。

（三）2019-2020 年客户 S 未向公司采购快速热处理设备的原因，2021 年公司对客户 R、客户 S 的销售及在手订单情况，发行人在美国的新客户拓展情况

公司与客户 S 及客户 R 已有超过 10 年的合作历史。2018 年，公司向客户 S 销售 1 台单价较高的 Millios® 系列毫秒退火热处理设备，对应的销售收入公司已申请豁免披露。2019 年及 2020 年，客户 S 未向公司采购快速热处理设备与客户自身的生产计划、扩产需求、资本开支规划相关，原毫秒退火热处理设备已经能够满足客户当前的生产经营需要。报告期内，公司与客户 S 保持良好合作关系，

并持续向客户 S 销售干法去胶设备。

2021 年 1-6 月，公司对客户 R 和客户 S 已实现销售的干法去胶设备共计 6 台，在手订单对应的干法去胶设备共计 10 台，包括已发货待完成验收、已下单待发货的干法去胶设备。

除客户 S 及客户 R 外，公司亦在积极拓展美国地区业务以增加美国市场销售收入。截至目前，公司已与美国半导体制造商、纳斯达克上市公司客户 CC 达成业务合作。

二、请保荐机构、申报会计师核查上述事项并发表明确意见

（一）核查程序

针对上述事项，保荐机构及申报会计师执行了以下核查程序：

- 1、取得报告期内分应用制程的设备销售明细表，了解及分析应用于 5nm 以内产品收入大幅下降、10-28nm 产品收入大幅上升的原因及合理性；
- 2、访谈发行人管理层及销售部门负责人，查阅公开信息，获取并阅读行业报告，了解行业变动趋势及发行人销售战略规划；
- 3、取得并审阅发行人区分定制化、通用型备品备件的收入、成本明细表，分析毛利率情况；
- 4、访谈发行人管理层及销售部门负责人，了解客户 S 2019 年、2020 年未向发行人采购快速热处理设备的原因，取得并审阅发行人 2021 年 1-6 月销售及发货明细表，核实发行人对客户 R、客户 S 的销售及在手订单情况，了解发行人在美国的新客户拓展情况。

（二）核查意见

经核查，保荐机构及申报会计师认为：

- 1、2019 年-2020 年，发行人应用于 5nm 以内的干法去胶设备收入大幅下降、10-28nm 产品收入大幅上升的原因具有合理性，与行业变动趋势不存在明显差异；
- 2、报告期各期，发行人定制化、通用型备品备件的收入占比和毛利率具有

商业合理性；

3、2019-2020年，客户 S 未向发行人采购快速热处理设备具有合理性，发行人已补充说明2021年对客户 R、客户 S 的销售及在手订单情况，发行人在美国的新客户拓展已取得一定进展。

3. 关于毛利率

根据问询回复，客户 B 为公司在干法刻蚀设备领域的国内战略客户，公司向客户 B 销售的刻蚀设备平均单价低于市场平均价格，报告期内公司向客户 B 销售毛利率分别为 X%、X%和 X%。

请发行人说明：公司向客户 B 销售毛利率波动较大的原因，2019 年毛利率为 X 的原因及商业合理性。

请申报会计师核查上述事项并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）报告期内毛利率波动较大的原因

对于报告期内公司向客户 B 销售的干法刻蚀设备情况表格，公司已申请豁免披露。

报告期内，公司向客户 B 销售干法刻蚀设备分别为 X 台、X 台及 X 台，因设备销售台数少，平均单价、单位成本等平均值的统计学意义和代表性相对不足。报告期内，公司向客户 B 销售的干法刻蚀设备毛利率在不同年度波动较大的主要原因为：

1、报告期内，发行人刻蚀设备尚在改进、定型、客户认证过程中，公司不同年度向客户 B 进行市场开拓的产品类型及销售策略存在区别，导致设备平均单价存在一定波动。公司 2018 年向客户 B 销售刻蚀设备的单价及成本与其他客户不存在重大差异。随着国内集成电路行业景气度逐步提升及公司北京制造基地

正式投产，2019 年成为公司国内市场开拓的关键时期，为更好的吸引客户 B 引进公司刻蚀设备，促进双方在产品及技术方面的可持续合作，公司 2019 年销售的设备单价显著低于 2018 年；

2、报告期内，公司主营的 ParadigmE[®]系列产品单位成本在 X-X 万元之间，因客户定制化要求不同、原材料价格波动、汇率波动等因素影响而有所差异。2019 年，公司仅向客户 B 销售 X 台刻蚀设备，成本为 X 万元，高于 2018 年和 2020 年的平均成本水平。

综合上述各年销售单价以及单位成本的波动原因分析，报告期内公司向客户 B 销售毛利率波动较大具有合理性。

(二) 2019 年毛利率为 X 的原因及商业合理性

对于公司向客户 B 及其他客户销售干法刻蚀设备的销售情况对比表格，公司已申请豁免披露。

公司 2019 年向客户 B 销售的干法刻蚀设备毛利率为 X 主要系销售价格低于平均市场价格所致。

如上文所述，客户 B 是公司重要的战略客户之一，2019 年是公司国内市场开拓的关键时期。为与客户 B 建立长期稳定的合作关系，公司当年以显著低于市场平均单价水平的价格向客户 B 销售了 X 台干法刻蚀设备。

报告期内，公司干法刻蚀设备已通过客户 B 的验证，2020 年干法刻蚀设备的销售数量取得一定增长。

综上，2019 年公司向客户 B 销售的干法刻蚀设备毛利率为 X 具有商业合理性。

二、请申报会计师核查上述事项并发表明确意见

(一) 核查程序

针对上述事项，申报会计师执行了以下核查程序：

1、取得报告期内发行人向客户 B 的销售明细数据，结合主要产品的单位销

售价格、单位成本等因素变化情况对毛利率波动进行分析；

2、访谈发行人管理层及销售部门负责人，核查发行人生产经营数据，了解发行人向客户 B 的销售策略及产品定价情况；

3、审阅发行人报告期内向客户 B 给予价格优惠的相关内部审批文件等。

（二）核查意见

经核查，申报会计师认为：

公司向客户 B 销售毛利率波动较大及 2019 年毛利率为 X 具有商业合理性。

保荐机构总体意见

对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京屹唐半导体科技股份有限公司《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件第二轮审核问询函的回复》之签章页）

北京屹唐半导体科技股份有限公司

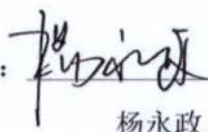


2024年8月15日

发行人董事长声明

本人已认真阅读《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件第二轮审核问询函的回复》的全部内容，确认审核问询函回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

发行人董事长：


杨永政

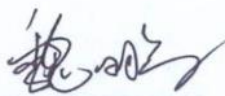
北京屹唐半导体科技股份有限公司



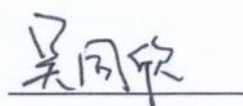
2021年8月15日

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》之签章页）

保荐代表人：



魏鹏



吴同欣

国泰君安证券股份有限公司

2021年8月15日

保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》的全部内容，了解本问询函回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本问询函回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人（主承销商）董事长：_____



贺青

国泰君安证券股份有限公司

2021 年 8 月 15 日

